

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成19年10月25日(2007.10.25)

【公開番号】特開2005-136370(P2005-136370A)

【公開日】平成17年5月26日(2005.5.26)

【年通号数】公開・登録公報2005-020

【出願番号】特願2004-44030(P2004-44030)

【国際特許分類】

H 01 L 21/31 (2006.01)

H 01 L 21/22 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/31 E

H 01 L 21/22 501N

H 01 L 21/22 511Q

【手続補正書】

【提出日】平成19年9月7日(2007.9.7)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板を処理する処理室と、前記基板の正面と平行方向に位置し前記処理室を囲う第1の加熱手段と、前記基板の正面と垂直方向に位置し前記処理室の上方に設けた第2の加熱手段と前記処理室の温度を検出する第1の温度検出手段と、前記第2の加熱手段近傍の温度を検出する第2の温度検出手段と、前記第1の加熱手段と前記第2の加熱手段とを制御する制御装置とを有する基板処理装置において、

前記制御装置は、

第1の温度設定値と前記第1の温度検出手段が検出する温度との偏差を演算し第1の加算器を介して帰算処理する第1の制御で前記第1の加熱手段を制御し、

第2の温度設定値と前記第2の温度検出手段が検出する温度との偏差を演算し第2の加算器を介して帰算処理する第2の制御と前記処理室内の所定の温度での電力出力値を予め設定し該設定された出力値による第3の制御とを前記所定の温度で切替えて前記第2の加熱手段を制御することを特徴とする基板処理装置。